

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-072

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。

##### （二）募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额及余额如下：

单位：人民币元

| 项目                         | 金额                |
|----------------------------|-------------------|
| 募集资金到位金额                   | 3,429,570,000.00  |
| 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 | -358,131,282.05   |
| 减：本期直接投入募投项目的金额            | -                 |
| 减：前期直接投入募投项目的金额            | -3,020,581,226.28 |
| 减：暂时闲置募集资金现金管理金额           | -                 |
| 加：理财收益及利息                  | 86,032,062.94     |
| 减：节余募集资金永久补充流动资金（注1）       | -124,451,591.10   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 减：汇率变动对现金及现金等价物的影响（注 2） | -12,437,963.51 |
| 募集资金期末余额                | -              |

注 1：截至 2024 年底，越南厂可穿戴设备生产项目和墨西哥厂新建第二工厂项目已结项，节余募集资金 12,433.43 万元及其后孳息 11.73 万元，共计 12,445.16 万元，永久补充流动资金。其中越南厂可穿戴设备生产项目对应的境内和境外募集资金专户、墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境内募集资金专户中的节余募集资金共计 43,850,396.90 元已于 2024 年 12 月转至公司一般户，墨西哥厂新建第二工厂项目对应的境外募集资金专户中的 80,601,194.19 元已于 2025 年 1 月转至公司一般户。

注 2：越南专户、墨西哥专户为外币账户，其账户本期支出按照当年度平均汇率折算为人民币，计入“本期直接投入募投项目的金额”，历史期间的期末余额以年末汇率折算为人民币。折算差额计入“汇率变动对现金及现金等价物的影响”中。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度

为了规范公司募集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》并严格按照该制度的规定存放、使用、管理资金。

### （二）募集资金监管协议签署及执行情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2021 年 3 月 1 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并同意公司与保荐机构、相应开户银行分别签署募集资金监管协议，对可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。

2021 年 3 月 25 日，公司与中国银行上海市南汇支行营业部、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、保荐机构海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。其中，由于对应的募集资金投资项目已完成，中国银行上海市南汇支行营业部、中国建设银行上海宝钢宝山支行、富邦华一银行

有限公司上海徐汇支行的募集资金专户已于 2023 年注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

对于募集资金涉及以子公司为投资主体的募集资金投资项目，为加强募集资金使用和管理，公司及保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与全资子公司环荣电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州厂”）和中国民生银行股份有限公司深圳分行、与全资子公司 Universal Scientific Industrial Vietnam Company Limited（以下简称“越南厂”）和 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。其中，由于对应的募集资金投资项目已完成，全资子公司环荣电子（惠州）有限公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户于 2023 年注销，签订的相关《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

根据公司 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和债券持有人会议决议，公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金（含利息）人民币 8,797.84 万元，惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币 30,000.00 万元和节余的募集资金（含利息）4,755.46 万元，合计人民币 43,553.30 万元，全部用于向子公司 Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.（以下简称“墨西哥厂”）增资 6,000 万美元（或等值人民币，具体金额以实际换汇金额计算，差额部分以自有资金补足），增资资金将用于“墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款，由墨西哥厂负责实施。

上述程序履行完后，公司及墨西哥厂已根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行重新签署募集资金监管协议。2023 年 11 月 14 日公司与交通银行上海新区支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。2023 年 11 月 30 日公司及墨西哥厂与 Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的

要求不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户已经全部注销，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司共开立 9 个募集资金专户，已全部注销，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                                                      | 银行账号                  | 募集资金余额 | 项目                  | 状态     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| 中国银行上海市南汇支行营业部                                            | 442981110010          | 0      | 盛夏厂芯片模组生产项目         | 已注销    |
| 中国建设银行上海宝钢宝山支行                                            | 31050168360000007485  | 0      | 惠州厂电子产品生产项目         | 已注销    |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行                                          | 632648187             | 0      | 惠州厂电子产品生产项目         | 已注销    |
| 富邦华一银行有限公司上海徐汇支行                                          | 50300003130014699     | 0      | 补充流动资金项目            | 已注销    |
| 招商银行股份有限公司上海外滩支行                                          | 121902408810808       | 0      | 越南厂可穿戴设备生产项目        | 已注销    |
| BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH | 100000600381093       | 0      | 越南厂可穿戴设备生产项目        | 已注销    |
| 交通银行上海新区支行                                                | 310066111013007546476 | 0      | 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 已注销    |
| Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 00100300900003135     | 0      | 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 已注销(注) |
|                                                           | 00100300900003124     | 0      | 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 已注销(注) |
| 合计                                                        |                       | 0      |                     |        |

注：截至 2024 年 12 月 31 日，墨西哥厂项目已结项，账户中的节余募集资金用于公司永久补充流动资金；该项目的境外专户余额于 2025 年 1 月初转出至公司一般户，专户于 2025 年 2 月 6 日完成销户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行可转债募集资金实际到位之前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入。2021年3月25日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年3月10日自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目和支付发行费用的实际支出情况，出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目和支付发行费用情况的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第E00040号）。

公司于2021年3月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用358,131,282.05元人民币。具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称         | 项目总投资            | 本次募集资金使用金额       | 置换金额           |
|----|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 1  | 盛夏厂芯片模组生产项目  | 910,000,000.00   | 860,000,000.00   | 198,557,469.91 |
| 2  | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 1,400,000,000.00 | 560,000,000.00   | 81,428,741.59  |
| 3  | 惠州厂电子产品生产项目  | 1,350,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 76,758,892.51  |
| 4  | 补充流动资金项目     | 1,030,000,000.00 | 1,030,000,000.00 | 0.00           |
| 5  | 发行费用         | 0.00             | 0.00             | 1,386,178.04   |
| 合计 |              | 4,690,000,000.00 | 3,450,000,000.00 | 358,131,282.05 |

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，集资金投资项目已全部结项，公司未进行闲置募集资金现金管理。

## （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

## （七）节余募集资金使用情况

募集资金项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，严格控制募集资金支出，加强对项

目费用的控制、监督和管理，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。此外，部分项目工程及设备支付周期较长，部分验收款、质保金等款项尚未达到支付条件，因此部分合同尾款尚未支付。为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元，共计12,445.16万元，永久补充流动资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.22条规定，募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议等程序。公司前述使用节余募集资金12,445.16万元低于募集资金净额5%，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况，已变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年8月27日

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                        |                   |            |           |                                                                                                                             |         |               |                                      |                              |                 |            |          |               |
|------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                 |                   |            |           | 342,957.00                                                                                                                  |         | 本年度投入募集资金总额   |                                      |                              |                 | 0          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额        |                   |            |           | 0                                                                                                                           |         | 已累计投入募集资金总额   |                                      |                              |                 | 337,871.25 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        |                   |            |           | 10.71%                                                                                                                      |         |               |                                      |                              |                 |            |          |               |
| 承诺投资项目投向               | 是否已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额（1）                                                                                                               | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计与承诺投入金额的差额（3）<br>(3) = (2)-(1) | 截至期末投资进度（%）<br>(4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本年度实现的效益   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 盛夏厂芯片模组生产项目            | 是                 | 86,000.00  | 79,283.01 | 79,283.01                                                                                                                   | 0       | 79,283.01     | 0.00                                 | 100.00%                      | 2023 年 7 月（已结项） | 注 1        | 注 1      | 否             |
| 越南厂可穿戴设备生产项目           | 是                 | 56,000.00  | 不适用       | 56,000.00                                                                                                                   | 0       | 53,082.26     | -2,917.74                            | 94.79%                       | 2024 年四季度（已结项）  | 注 2        | 注 2      | 否             |
| 惠州厂电子产品生产项目            | 是                 | 100,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00                                                                                                                   | 0       | 69,926.48     | -73.52                               | 99.89%                       | 2023 年三季度（已结项）  | 注 3        | 注 3      | 否             |
| 补充流动资金项目               | 否                 | 100,957.00 | 不适用       | 100,957.00                                                                                                                  | 0       | 101,037.47    | 80.47                                | 100.08%                      | 不适用             | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款    | 是<br>（新增项目）       | 不适用        | 43,479.78 | 43,479.78                                                                                                                   | 0       | 34,542.03     | -8,937.75                            | 79.44%                       | 2024 年四季度（已结项）  | 注 4        | 注 4      | 否             |
| 合计                     |                   | 342,957.00 | -         | 349,719.79                                                                                                                  | 0       | 337,871.25    | -11,848.54                           | 96.61%                       |                 |            |          |               |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） |                   |            |           | 不适用                                                                                                                         |         |               |                                      |                              |                 |            |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                   |            |           | 不适用                                                                                                                         |         |               |                                      |                              |                 |            |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                   |            |           | 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用人民币 358,131,282.05 元，该事项已经公司 2021 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，已于 2021 年度完成，详见本报告三、（二）。 |         |               |                                      |                              |                 |            |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                   |            |           | 不适用                                                                                                                         |         |               |                                      |                              |                 |            |          |               |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2025 年上半年，公司未使用募集资金进行现金管理，详见本报告三、（四）。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 详见本报告三、（七）                            |
| 募集资金使用其他情况             | 不适用                                   |

注 1：鉴于该项目为盛夏厂的技术升级项目，其实现的效益无法分割统计。

注 2：2025 年上半年，越南厂可穿戴设备生产项目实现净利润人民币 2,435.19 万元。因承诺的预计效益计算口径为全年效益，故“是否达到预计效益”为不适用。

注 3：2025 年上半年，惠州厂电子产品生产项目实现净利润人民币 14,123.33 万元。因承诺的预计效益计算口径为全年效益，故“是否达到预计效益”为不适用。

注 4：募集资金用于墨西哥厂新建第二工厂项目厂房建设，不直接产生经济效益，故不适用。



### 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]